



◆ 產品名稱：鋁箔（壓合用耗材）

◆ 產品說明

PCB 壓合製程，因材料於壓合過程中會產生流動，使得材料會溢出到鋼板上，為防止溢流所造成鋼板表面遭受污染進而影響到生產良率的問題，多數人會選擇銅箔做為防止溢流之材料。然而因銅之價格遠高於鋁，導致壓合製程之成本居高不下，故鋁箔取代銅箔之趨勢因而快速崛起。

◆ 產品特性：

PCB 壓合製程，為防止在壓合時溢膠至鋼板上，多數均使用銅箔做為防溢膠之材料，故下表為銅箔與鋁箔兩者特性比較：

特性	銅箔	鋁箔
成本	高	較低
耐溫度	高(熔點 1084°C)	中(熔點 660°C)
熱導率	401 W/mK	237 W/mK
導電性	59.6×10^6 S/m	37.8×10^6 S/m
密度	8.96 g/cm ³	2.7 g/cm ³
膨脹係數(25°C)	16.5 um/Mk	23.1 um/Mk
抗腐蝕性	佳	優於銅
莫氏硬度	3	2.75
維氏硬度	343~369 Mpa	245MPa

◆ 儲存

儲存於陰涼、乾燥(建議<60% RH)通風位置，避免陽光照射

以上資料及數據僅供參考，產品會依使用端之方法、情況及環境之不同而有所改變，故使用者需自行評估本產品是否符合其用途及應用。